

長庚大學 函

地址：33302桃園市龜山區文化一路259號
承辦人：莊皓鈞
電話：(03)2118800#5544
傳真：(03)2118668

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國113年5月30日

發文字號：長庚大字第1130050394號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：活動簡章及宣傳海報1份(長庚大學電資學群與 IC 設計大學課程體驗營活動資訊.pdf) (1130050394_Attach1.pdf)

主旨：敬邀參加本校工學院辦理「2024長庚大學電資學群與IC設計暑期大學體驗課程」活動，請貴校惠予公告並鼓勵學生踴躍參加，請查照。

說明：

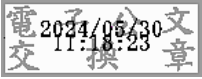
- 一、活動簡介：長庚大學有完整晶片設計軟硬體設施及晶片製造的無塵室環境，可讓高中職學生透過提前體驗大學電資學群與IC設計亮點課程，進行更具體的科系探索與專業認識，並藉由業界參訪、無塵室參訪、IC設計實驗實作、電資亮點5G實驗室及AI實驗室參訪，能更深入了解未來的職涯發展及學習規劃。
- 二、活動對象：全國各高中職學生(含應屆畢業生)。
- 三、活動時間：113年8月12日至8月16日08:00-17:00(共5梯次)。
- 四、活動地點：長庚大學工學院電機系、電子系及資工系。
- 五、活動報名：線上表單連結<https://forms.gle/hzDsh9QZkq7ZysFj9>。

松山工農 1130530



NOAA1133007213

正本：全國公私立高中職

副本：

校長 湯 明 哲



裝



訂

線